

行业及产业

机械设备

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：



资料来源：聚源数据

相关研究

《半导体设备行业点评：台积电设备采购预期上修，看好半导体设备及零部件》2026-09-07

《芯碁微装(688630.SH) 2026 半年报点评：高端 PCB 设备放量，先进封装业务加速突破》2026-08-28

《光通信设备行业点评：东山精密追加光电投资，看好光设备景气上行》2026-08-24

《天准科技(688003.SH)2026 半年报点评：AI 链精密装备整装待发，具身智能共驱成长》2026-08-21

《光通信设备行业点评：英伟达 CPO 全面量产，测试设备需求加速释放》2026-08-17

证券分析师

王凯
S0820524120002
021-32229888-25522
wangkai526@ajzq.com

中国台湾 AI 服务器 8 月出货跟踪：景气向上游传导

——半导体设备行业点评

投资要点：

- **事件：8 月中国台湾 AI 服务器产业链营收创新高，整机出货明显提速。**49 家中国台湾上市 AI 服务器供应链公司（涵盖 A 服务器组装、散热、电源、基板、材料、网络、测试和光学）8 月合计营收 2.8 万亿新台币，同比增长 76.5%、环比增长 9.9%，同比增速较 7 月的 61.3% 进一步提升。其中 ODM/EMS 营收 2.1 万亿新台币，同比增长 86.1%、环比增长 11.0%。7 月零部件收入环比增长 9.9%、整机仅增长 4.8%，8 月则切换为整机增长 11.0%、零部件增长 1.6%，反映前期备料正逐步转化为服务器组装及交付，AI 服务器需求仍处于向上阶段。
- **AI 服务器产业链供需矛盾向上游关键物料集中，供给约束仍为整机放量的主要限制。**Inventec 表示，PCB、存储、SSD 及 MLCC 供应偏紧已造成部分服务器物料无法配齐，纬颖指出 CPU 短缺短期难以缓解。上游交期同步拉长，信骅 BMC 交期已延长至 36 周，颖威高端测试座交期达到 13-14 周。对应来看，8 月覆铜板、BMC 及测试环节收入分别同比增长 124.5%、118.4%、62.0%，紧缺环节维持较高景气。我们判断，AI 服务器需求正由整机放量进一步转化为上游扩产需求，其中 GPU 先进制程及先进封装、HBM 存储与封装、高速多层 PCB 是资本开支较为集中的方向；当前关键物料交期拉长进一步强化扩产必要性，晶圆制造、封装测试及 PCB 设备有望率先受益。
- **云厂商资本开支持续上修，AI 基础设施投入仍处于加速阶段。**TrendForce 最新预计，Google、Amazon、Meta、Microsoft、Oracle 及中国四大 CSP 等全球九大云厂商 2026 年资本开支将超过 8,867.0 亿美元，同比增长约 90.0%，其中北美五大云厂商贡献接近 90.0%；2027 年九大 CSP 资本开支预计进一步达到约 1.3 万亿美元，同比增长近 50.0%。根据 Dell' Oro Group 预计，全球数据中心资本开支将在 2026 年突破 1 万亿美元，并于 2030 年超过 3 万亿美元，其中 AI 加速服务器相关高端加速器将成为资本开支最大的组成部分。资本开支持续上修，AI 算力建设仍在向纵深发展，需求将由 GPU 进一步向服务器、PCB 及高速材料、光通信、散热、电源等基础设施环节扩散。
- **PCB 是当前供给约束向资本开支传导最清晰的环节之一，高端产能扩张有望进入加速期。**8 月 PCB 收入同比增长 56.8%，覆铜板同比增长 124.5%，Inventec 已直接将 PCB 列入影响服务器交付的紧缺物料。材料端，Elite Material 部分长期合约产能未来两年已经售罄，M9 进入量产；Iteq 计划将月产能由 2026 年底约 570 万张提升至 2029 年底 915 万张，新增产能主要投向 M7 及以上产品。AI 服务器 PCB 持续向高多层、高速材料、更细线路及更高密度互连升级，工艺复杂度提升带动曝光、钻孔、电镀及检测设备配置强度提升。当前高速材料扩产已率先启动，高端 PCB 产能亦维持偏紧，板厂后续资本开支有望继续提升，PCB 设备供应商有望率先受益于新一轮扩产。
- **投资建议：AI 服务器持续放量，将拉动 GPU、HBM、PCB 等关键环节的新增产能投入。随着云厂商资本开支持续扩张，产业链景气有望沿“服务器出货—关键物料紧张—上游扩产—设备订单”进一步传导。**建议关注【晶圆制造设备和零部件】海外设备链关注应用材料 (AMAT.O)、Lam Research(LRCX.O)、KLA(KLAC.O)、MKS(MKSI.O)；国产设备链关注北方华创(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)、拓荆科技(688072.SH)、精测电子(300567.SZ)、精智达(688627.SH)，核心零部件关注先锋精科(688605.SH)、高凯技术(688835.SH)、超纯应材(301717.SZ)；【PCB 及先进封装设备】关注芯碁微装(688630.SH、9630.HK)、盛美上海(688082.SH)、大族数控(301200.SZ)、东威科技(688700.SH)。
- **风险提示：**AI 基础设施资本开支不及预期；AI 服务器出货及上游扩产进度不及预期；PCB、高速材料、先进封装等环节技术迭代及设备导入进度不及预期。

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15%之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5%之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。